

New!!

Kemet LFPプレート

金属コンタミレスを実現！



加工条件

被加工物: アルミナセラミック 98%
定盤径: 15インチ
スラリー: 9 μ 多結晶ダイヤモンドスラリー
噴霧量: 2秒/30秒インターバル
加圧: 180g/cm²
回転数: 50rpm
加工時間: 30min

Kemet LFPプレートの特徴

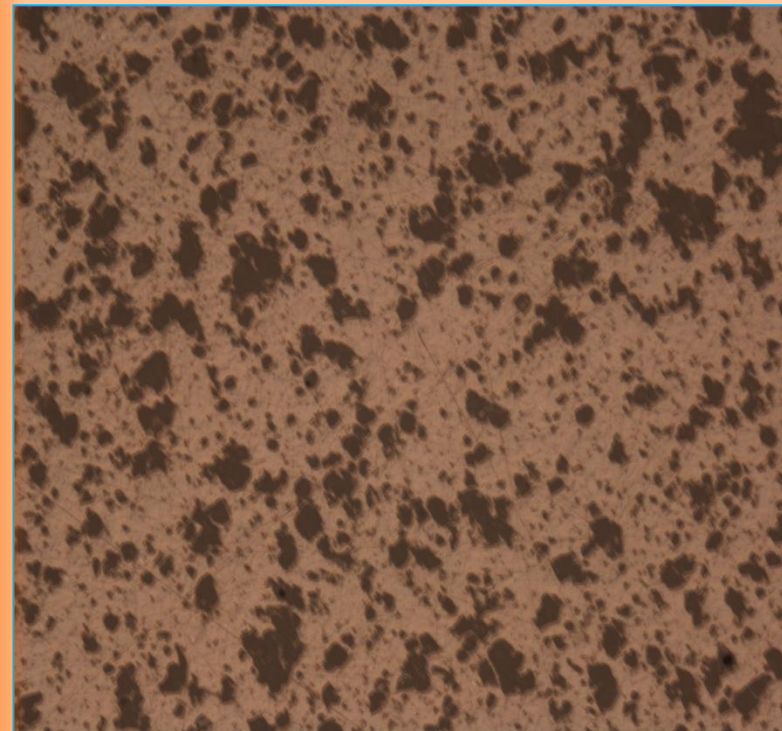
- ・完全メタルフリー
- ・粗工程、中仕上げ工程で使用可

詳細は、お問い合わせください

金属が含有されたプレートでの研磨面



Kemet LFPプレートでの研磨面



ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト21階

TEL: 043-213-9911

FAX: 043-213-9932

INFO: info@kemet.jp

URL: www.kemet.jp

